

## SECCIÓN H — SECCION H — ELECTRICIDAD

## H05 TECNICAS ELECTRICAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR

**H05K CIRCUITOS IMPRESOS; ENVOLTURAS O DETALLES DE REALIZACION DE APARATOS ELECTRICOS; FABRICACION DE CONJUNTOS DE COMPONENTES ELECTRICOS** (detalles de instrumentos o detalles comparables de otros aparatos no previstos en otro lugar G12B; circuitos de película delgada o de película gruesa H01L 27/01, H01L 27/13; medios no impresos para realizar conexiones con o entre circuitos impresos H01R; envolturas o detalles de realización de tipos particulares de aparatos, ver las subclases apropiadas; procedimientos que sólo comprenden una técnica prevista en otro lugar, p. ej. calefacción, pulverización, ver la subclase apropiada)

Nota(s)

- (1) La presente subclase cubre:
- las combinaciones de un receptor de radio o de televisión con un aparato que tiene una función principal diferente;
  - los circuitos impresos estructuralmente asociados con componentes eléctricos no impresos.
- (2) En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:
- " circuitos impresos " cubre toda clase de estructuras mecánicas de circuitos que consisten en una base aislante que soporta el conductor y que están combinadas estructuralmente con el conductor en toda su longitud, especialmente en un plano bidimensional, estando fijados los conductores a la base de una manera indismontable; cubre igualmente los procedimientos o aparatos para la fabricación de tales estructuras, p. ej. constitución del circuito por tratamiento mecánico o químico de una lámina, pasta o película conductoras sobre un soporte aislante.

provide translation in ES ipc fixed texts.xml for id: subclass index

CIRCUITOS IMPRESOS ASOCIADOS O NO  
CON COMPONENTES ELECTRICOS NO  
IMPRESOS

Tipos; fabricación ..... 1/00; 3/00

ENVOLTURAS, CAJAS O CAJONES;  
DETALLES CONSTRUCTIVOS ..... 5/00; 7/00  
BLINDAJES ..... 9/00  
COMBINACIONES DE UN RECEPTOR DE  
RADIO O DE TELEVISION CON OTROS  
APARATOS ..... 11/00  
FABRICACION DE CONJUNTOS DE  
COMPONENTES ELECTRONICOS ..... 13/00  
DISPOSICIONES PARA MEJORAR LA  
FIABILIDAD ..... 10/00

- 1/00 Circuitos impresos** (conjuntos consistentes en una pluralidad de semiconductores o de otros dispositivos de estado sólido individuales H01L 25/00; dispositivos que consisten en una pluralidad de componentes de estado sólido formados en o sobre un sustrato común, p. ej. circuitos integrados, circuitos de película delgada o de película gruesa H01L 27/00) [1, 2006.01]
- 1/02 . Detalles [1, 2006.01]
- 1/03 . . Empleo de materiales para realizar el sustrato [3, 2006.01]
- 1/05 . . . Sustratos de metal aislado [3, 2006.01]
- 1/09 . . Empleo de materiales para realizar el recorrido metálico [3, 2006.01]
- 1/11 . . Elementos impresos para realizar conexiones eléctricas con o entre circuitos impresos [3, 2006.01]
- 1/14 . . Asociación estructural de varios circuitos impresos (medios de conexión eléctrica de circuitos con o entre circuitos impresos H05K 1/11, H01R 12/00) [1, 2006.01]
- 1/16 . incorporando componentes eléctricos impresos, p. ej. resistencias, condensadores o inductancias impresas [1, 2006.01]

- 1/18 . Circuitos impresos asociados estructuralmente con componentes eléctricos no impresos (H05K 1/16 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/00 Aparatos o procedimientos para la fabricación de circuitos impresos** (producción por vía fotomecánica de superficies texturadas, materiales a este efecto o sus originales, aparellajes especialmente adaptados a este efecto, en general G03F; que implican la fabricación de dispositivos semiconductores H01L) [1, 3, 2006.01]
- 3/02 . en los cuales el material conductor es aplicado a la superficie del soporte aislante y es en seguida quitado de zonas determinadas de la superficie, no destinadas a servir de conductoras de corriente o de elementos de blindaje [1, 2006.01]
- 3/04 . . Siendo eliminado el material conductor mecánicamente, p. ej. por punzonado [1, 2006.01]
- 3/06 . . Siendo eliminado el material conductor químicamente o electrolíticamente, p. ej. por el procedimiento de foto-decapado [1, 2006.01]
- 3/07 . . . Eliminación por vía electrolítica [3, 2006.01]
- 3/08 . . Siendo eliminado el material conductor por descarga eléctrica, p. ej. por electroerosión [1, 2006.01]

- 3/10 . en los cuales el material conductor es aplicado al soporte aislante de manera que forme el diseño de conductor deseado [1, 2006.01]
- 3/12 . . utilizando las técnicas de impresión para aplicar el material conductor [1, 2006.01]
- 3/14 . . utilizando las técnicas de vaporización para aplicar el material conductor [1, 2006.01]
- 3/16 . . . por pulverización catódica [1, 2006.01]
- 3/18 . . utilizando técnicas de precipitación para aplicar el material conductor [1, 2006.01]
- 3/20 . . por aplicación de un diseño de conductor prefabricado [1, 2006.01]
- 3/22 . Tratamientos secundarios de circuitos impresos [1, 2006.01]
- 3/24 . . Refuerzo del diseño conductor [1, 2006.01]
- 3/26 . . Limpieza o pulido del diseño conductor [1, 2006.01]
- 3/28 . . Aplicación de revestimiento de protección no metálicos [1, 2006.01]
- 3/30 . Acoplamiento de circuitos impresos con componentes eléctricos, p. ej. con una resistencia [1, 2006.01]
- 3/32 . . Conexiones eléctricas de componentes eléctricos o de hilos a circuitos impresos [1, 2006.01]
- 3/34 . . . Conexiones soldadas [1, 2006.01]
- 3/36 . Acoplamiento de circuitos impresos con otros circuitos impresos [1, 2006.01]
- 3/38 . Mejoramiento de la adherencia entre el sustrato aislante y el metal [3, 2006.01]
- 3/40 . Fabricación de elementos impresos destinados a realizar conexiones eléctricas con o entre circuitos impresos [3, 2006.01]
- 3/42 . . Agujeros de paso metalizados [3, 2006.01]
- 3/44 . Fabricación de circuitos con ánima metálica aislada [3, 2006.01]
- 3/46 . Fabricación de circuitos multicapas [3, 2006.01]
- 5/00 Envolturas, cajones o cajas para aparatos eléctricos** (en general A47B; ebanistería de receptores de radio H04B 1/08; ebanistería de receptores de televisión H04N 5/64) [1, 2006.01]
- 5/02 . Detalles [1, 2006.01]
- 5/03 . . Cubiertas; TRANSLATION PROBLEM 163 [1, 2006.01]
- 5/04 . Envolturas metálicas [1, 2006.01]
- 5/06 . Envolturas selladas herméticamente [1, 2006.01]
- 7/00 Detalles constructivos comunes a diferentes tipos de aparatos eléctricos** (envolturas, cajas, cajones H05K 5/00) [1, 2006.01]
- 7/02 . Disposiciones de componentes de circuitos o del cableado sobre una estructura de soporte [1, 2006.01]
- 7/04 . . sobre chasis conductores [1, 2006.01]
- 7/06 . . sobre paneles aislantes [1, 2006.01]
- 7/08 . . . sobre paneles perforados [1, 2006.01]
- 7/10 . . Montajes de componentes de contacto por clavija [1, 2006.01]
- 7/12 . . Medios elásticos o medios de apretado para fijar un componente a la estructura del conjunto (fijación de conectores de dos piezas H01R 13/00) [1, 2006.01]
- 7/14 . Montaje de la estructura del soporte en la envoltura, sobre el marco o sobre el armazón [1, 2006.01]
- 7/16 . . sobre articulaciones o sobre pivotes [1, 2006.01]

- 7/18 . Construcción de armazones o marcos [1, 2006.01]
- 7/20 . Modificaciones para facilitar la refrigeración, ventilación o calefacción [1, 2006.01]

**9/00 Blindaje de aparatos o de componentes contra los campos eléctricos o magnéticos** (dispositivos absorbentes de la radiación de una antena H01Q 17/00) [1, 2006.01]

**10/00 Disposiciones para mejorar la seguridad de funcionamiento del equipo electrónico, p. ej. por provisión de una unidad de reserva similar** [1, 2006.01]

#### Nota(s) [6]

Es importante tener en cuenta los siguientes lugares apropiados:

- |      |        |  |
|------|--------|--|
| G05B | 9/03   | Sistemas eléctricos de control redundantes   |
| G06F | 11/16  | Detección o corrección de errores de un dato por redundancia del hardware en un computador digital                             |
| G08B | 29/16  | Sistemas redundantes de señalización o de alarma de seguridad  |
| H02H | 3/05   | Circuitos de protección de seguridad redundantes   |
| H02J | 3/38   | Disposiciones para la alimentación en paralelo de una sola red de distribución eléctrica                                       |
| H02J | 9/04   | Circuitos para la alimentación de potencia de reserva  |
| H03K | 19/003 | Modificaciones para incrementar la fiabilidad de circuitos lógicos o de los circuitos de inversión                             |
| H03K | 19/007 | Circuitos lógicos o circuitos de inversión que garantizan la seguridad en caso de fallo eléctrico                              |
| H03L | 7/07   | Generación de una señal de reloj redundante en los generadores de oscilaciones o de impulsos electrónicos                      |
| H04B | 1/74   | Sistemas de transmisión que utilizan canales o aparatos redundantes  |
| H04L | 1/22   | Aparatos redundantes para incrementar la fiabilidad de los dispositivos utilizados para la transmisión de información digital. |

**11/00 Combinaciones de un receptor de radio o de televisión con aparatos que tienen una función principal diferente** [1, 2006.01]

- 11/02 . con vehículos [1, 2006.01]

**13/00 Aparatos o procedimientos especialmente adaptados para la fabricación o el ajuste de conjuntos de componentes eléctricos** [1, 2006.01]

- 13/02 . Introducción de componentes (en general B65G) [1, 2006.01]
- 13/04 . Montaje de componentes [1, 2006.01]
- 13/06 . Cableado por máquina [1, 2006.01]
- 13/08 . Control de la fabricación de los conjuntos [1, 2006.01]